



PCB DEFINITION	
Layer count :	2
Board thickness :	1,6mm
Board material :	FR4
Surface :	Copper 35um + NiAu
Minimum track width :	>= 0.15mm
Minimum copper gaps :	>= 0.15mm
Minimum drill diameter :	>= 0.3mm
Solder mask color :	Green
Silkscreen color :	
GERBER FILES	
Layer1 Top :	X
Layer 2 Bottom :	X
Layer 3 :	-
Layer4 :	-
Solder Mask Top :	X
Solder Mask Bottom :	X
Silkscreen Top :	-
Silkscreen Bottom :	-
Drill drawing :	X
Drill excellon :	X
Paste mask top :	X
Paste mask bottom :	-
Assembly Top :	X
Assembly Bottom :	-

Désignation :	Opto V01
Validation :	B. Chiron 12/02/2016
ASSEMBLY :	TOP



PCB DEFINITION	
Layer count :	2
Board thickness :	1,6mm
Board material :	FR4
Surface :	Copper 35um + NiAu
Minimum track width :	>= 0.15mm
Minimum copper gaps :	>= 0.15mm
Minimum drill diameter :	>= 0.3mm
Solder mask color :	Green
Silkscreen color :	
GERBER FILES	
Layer1 Top :	X
Layer 2 Bottom :	X
Layer 3 :	—
Layer4 :	—
Solder Mask Top :	X
Solder Mask Bottom :	X
Silkscreen Top :	—
Silkscreen Bottom :	—
Drill drawing :	X
Drill excellon :	X
Paste mask top :	X
Paste mask bottom :	—
Assembly Top :	X
Assembly Bottom :	—

Désignation :	Opto V01
Validation :	B. Chiron 12/02/2016
LAYER 1 :	TOP



PCB DEFINITION	
Layer count :	2
Board thickness :	1,6mm
Board material :	FR4
Surface :	Copper 35um + NiAu
Minimum track width :	>= 0.15mm
Minimum copper gaps :	>= 0.15mm
Minimum drill diameter :	>= 0.3mm
Solder mask color :	Green
Silkscreen color :	
GERBER FILES	
Layer1 Top :	X
Layer 2 Bottom :	X
Layer 3 :	—
Layer4 :	—
Solder Mask Top :	X
Solder Mask Bottom :	X
Silkscreen Top :	—
Silkscreen Bottom :	—
Drill drawing :	X
Drill excellon :	X
Paste mask top :	X
Paste mask bottom :	—
Assembly Top :	X
Assembly Bottom :	—

Désignation :	Opto V01
Validation :	B. Chiron 12/02/2016
LAYER 2 :	BOTTOM



PCB DEFINITION	
Layer count :	2
Board thickness :	1,6mm
Board material :	FR4
Surface :	Copper 35um + NiAu
Minimum track width :	>= 0.15mm
Minimum copper gaps :	>= 0.15mm
Minimum drill diameter :	>= 0.3mm
Solder mask color :	Green
Silkscreen color :	
GERBER FILES	
Layer1 Top :	X
Layer 2 Bottom :	X
Layer 3 :	—
Layer4 :	—
Solder Mask Top :	X
Solder Mask Bottom :	X
Silkscreen Top :	—
Silkscreen Bottom :	—
Drill drawing :	X
Drill excellon :	X
Paste mask top :	X
Paste mask bottom :	—
Assembly Top :	X
Assembly Bottom :	—
Désignation :	Opto V01
Validation :	B. Chiron 12/02/2016
PASTE MASK TOP	



PCB DEFINITION	
Layer count :	2
Board thickness :	1,6mm
Board material :	FR4
Surface :	Copper 35um + NiAu
Minimum track width :	>= 0.15mm
Minimum copper gaps :	>= 0.15mm
Minimum drill diameter :	>= 0.3mm
Solder mask color :	Green
Silkscreen color :	
GERBER FILES	
Layer1 Top :	X
Layer 2 Bottom :	X
Layer 3 :	—
Layer4 :	—
Solder Mask Top :	X
Solder Mask Bottom :	X
Silkscreen Top :	—
Silkscreen Bottom :	—
Drill drawing :	X
Drill excellon :	X
Paste mask top :	X
Paste mask bottom :	—
Assembly Top :	X
Assembly Bottom :	—
Désignation :	Opto V01
Validation :	B. Chiron 12/02/2016
Solder Mask Top	



PCB DEFINITION	
Layer count :	2
Board thickness :	1,6mm
Board material :	FR4
Surface :	Copper 35um + NiAu
Minimum track width :	>= 0.15mm
Minimum copper gaps :	>= 0.15mm
Minimum drill diameter :	>= 0.3mm
Solder mask color :	Green
Silkscreen color :	
GERBER FILES	
Layer1 Top :	X
Layer 2 Bottom :	X
Layer 3 :	—
Layer4 :	—
Solder Mask Top :	X
Solder Mask Bottom :	X
Silkscreen Top :	—
Silkscreen Bottom :	—
Drill drawing :	X
Drill excellon :	X
Paste mask top :	X
Paste mask bottom :	—
Assembly Top :	X
Assembly Bottom :	—

Désignation :	Opto V01
Validation :	B. Chiron 12/02/2016
SOLDER MASK BOTTOM	